

微电子封装技术



[微电子封装技术_下载链接1](#)

著者:中国电子学会生产技术学分会丛书编委会 编

出版者:中国科学技术大学出版社

出版时间:2003-4

装帧:

isbn:9787312014253

《微电子封装技术(修订版)》比较全面、系统、深入地论述了在晶体管 and 集成电路 (IC

）发展的不同历史时期出现的典型微电子封装技术，着重论述了当前应用广泛的先进IC封装技术-QFP、BGA、CSP、FCB、MCM和3D封装技术，并指出了微电子封装技术今后的发展趋势。全书共分8章，内容包括：绪论；芯片互连技术；插装元器件的封装技术；表面安装元器件的封装技术；BGA和CSP的封装技术；多芯片组件（MCM）；微电子封装的基板材料、介质材料、金属材料及基板制作技术；未来封装技术展望。书后还附有微电子封装技术所涉及的有关缩略语的中英文对照等，以便读者查阅。《微电子封装技术(修订版)》涉及的知识面广，又颇具实用性，适合于从事微电子封装研发、生产的科技人员及从事SMT的业界人士阅读，也是高校相关专业师生的一本有价值的参考书。

作者介绍:

目录:

[微电子封装技术_下载链接1](#)

标签

微电子封装

评论

[微电子封装技术_下载链接1](#)

书评

[微电子封装技术_下载链接1](#)